

⑫ 公開実用新案公報(U) 平4-56347

⑤ Int. Cl.⁵

H 01 L 23/50

識別記号

N

庁内整理番号

8418-4M

⑬ 公開 平成4年(1992)5月14日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全1頁)

⑭ 考案の名称 半導体装置

⑯ 実 願 平2-99977

⑰ 出 願 平2(1990)9月25日

⑱ 考 案 者 加 藤 友 明 山形県山形市北町4丁目12番12号 山形日本電気株式会社
内

⑲ 出 願 人 山形日本電気株式会社 山形県山形市北町4丁目12番12号

⑳ 代 理 人 弁理士 内 原 晋

㉑ 実用新案登録請求の範囲

半導体素子を封止した封止体から突出した外部リードのうち、少なくとも実装基板と対向する表面は、凹凸加工が施されていることを特徴とする半導体装置。

図面の簡単な説明

第1図は本考案の第1の実施例の半導体装置の

実装時の断面図、第2図は本考案の第2の実施例の断面図、第3図は従来の半導体装置の実装時の断面図である。

1……外部リード端子先端部、2……外部リード端子最先端部、3……接合材、4……実装基板、5……外部リード端子裏側の接合部、6……封入材。

